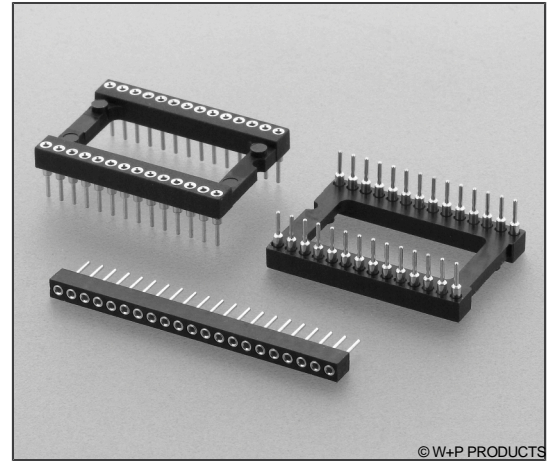


### Technische Daten / Technical Data

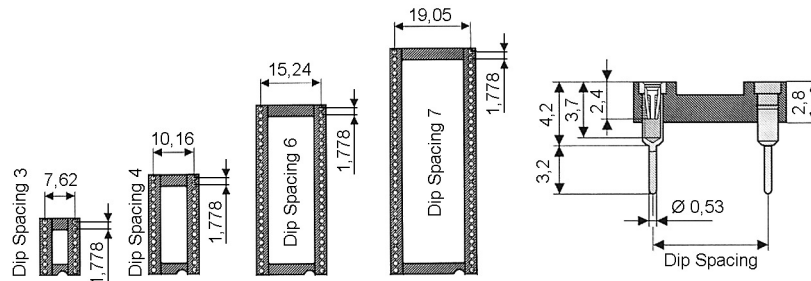
Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV RMS
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



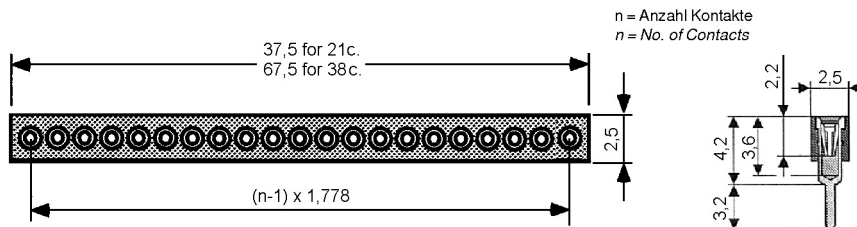
© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm  
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.  
For Ø0.40-0.56mm round pins  
or 0.25x0.45mm rectangular pins.

### IC-Fassung Serie 326 IC-Socket Series 326



### IC-Leiste Serie 327 IC-Strip Series 327



n = Anzahl Kontakte  
n = No. of Contacts

<b>Series</b> <b>326</b> 326 IC-Fassung IC-Socket	<b>Contacts*</b> <b>16</b> 16 =====> 28/30/32/48 =====> 20/24/28/40/42/48/ 50/52/56/64/68=====> 64 =====>	<b>DIP-Spacing*</b> <b>3</b> 3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 7 19,05mm	<b>Sleeve Plating</b> <b>50</b> 50 Verzinkt (Standard) Tin plated (Standard)	<b>Clip Plating*</b> <b>00</b> 00 Vergoldet Gold plated 10 Vergoldet 0,25µm (Option) 0,25µm gold plated (Option) 30 Vergoldet 0,75µm 0,75µm gold plated
<b>Series</b> <b>327</b> 327 IC-Leiste IC Header	<b>Contacts*</b> <b>21</b> 21/38 Einreihig Single row	<b>Rows</b> <b>1</b> 1 Einreihig Single row	<b>Sleeve Plating</b> <b>50</b> 50 Verzinkt (Standard) Tin plated (Standard)	<b>Clip Plating*</b> <b>00</b> 00 Vergoldet Gold plated 10 Vergoldet 0,25µm (Option) 0,25µm gold plated (Option)

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

